

【11】證書號數：M369204

【45】公告日：中華民國 98 (2009) 年 11 月 21 日

【51】Int. Cl. : *B23K3/06 (2006.01)* *H01L21/60 (2006.01)*

新型

全 8 頁

---

【54】名稱：錫球承載治具

【21】申請案號：098211894

【22】申請日：中華民國 98 (2009) 年 07 月 01 日

【72】創作人：何應森 (TW)；曾憲威 (TW)；李揚漢 (TW)

【71】申請人：何應森

臺北縣新莊市中華路 2 段 306 號 16 樓

曾憲威

臺北縣新莊市中華路 2 段 306 號 16 樓

李揚漢

臺北縣新莊市中華路 2 段 306 號 16 樓

【74】代理人：桂齊恆；閻啟泰

[57]申請專利範圍

1. 一種錫球承載治具，包括有：一本體，其具有一上表面；一孔穴陣列，其具有複數凹設於前述本體之上表面的定位孔，各定位孔係匹配於待植球晶片底部的焊墊。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之錫球承載治具，前述本體係形成為方形塊體。

圖式簡單說明

第一圖係本創作之立體圖。

第二圖係於本創作之孔穴陣列上設置錫球之使用示意立體圖。

第三圖係於本創作之孔穴陣列上設置錫球並對應於球柵陣列封裝晶片底部之使用示意側面圖。

第四圖係將本創作之孔穴陣列之錫球設置於球柵陣列封裝晶片底部之使用示意側面圖。

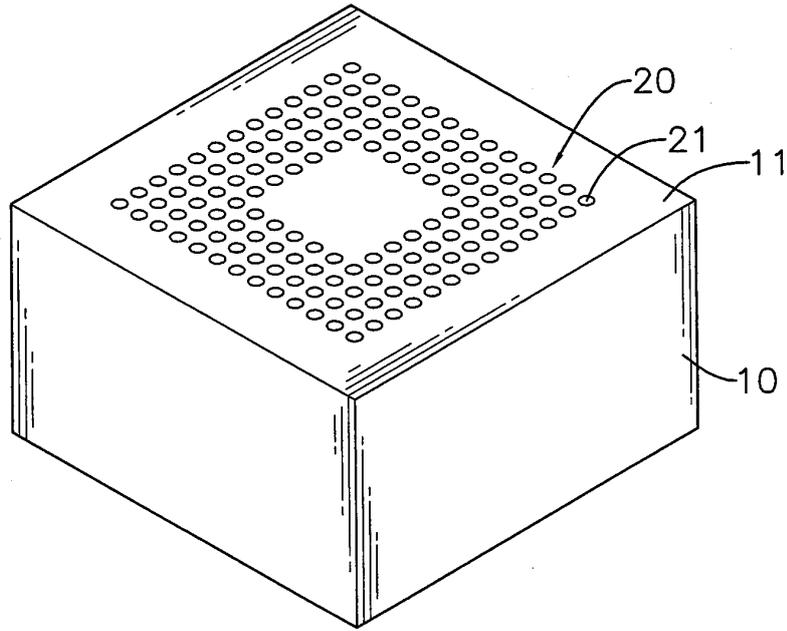
第五圖係藉本創作之孔穴陣列設置錫球於球柵陣列封裝晶片底部之後的使用示意側面圖。

第六圖係既有雙排型封裝晶片之仰視立體圖。

第七圖係既有雙排型封裝晶片之正面圖。

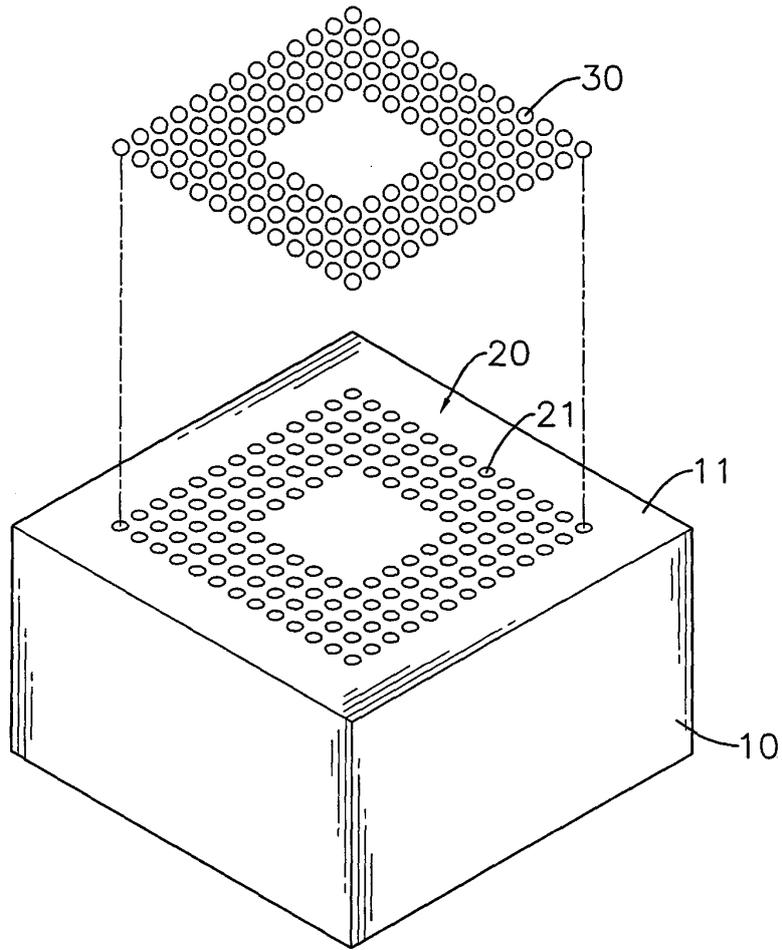
第八圖係於球格陣列封裝晶片底部設置錫球之仰視立體圖。

(2)



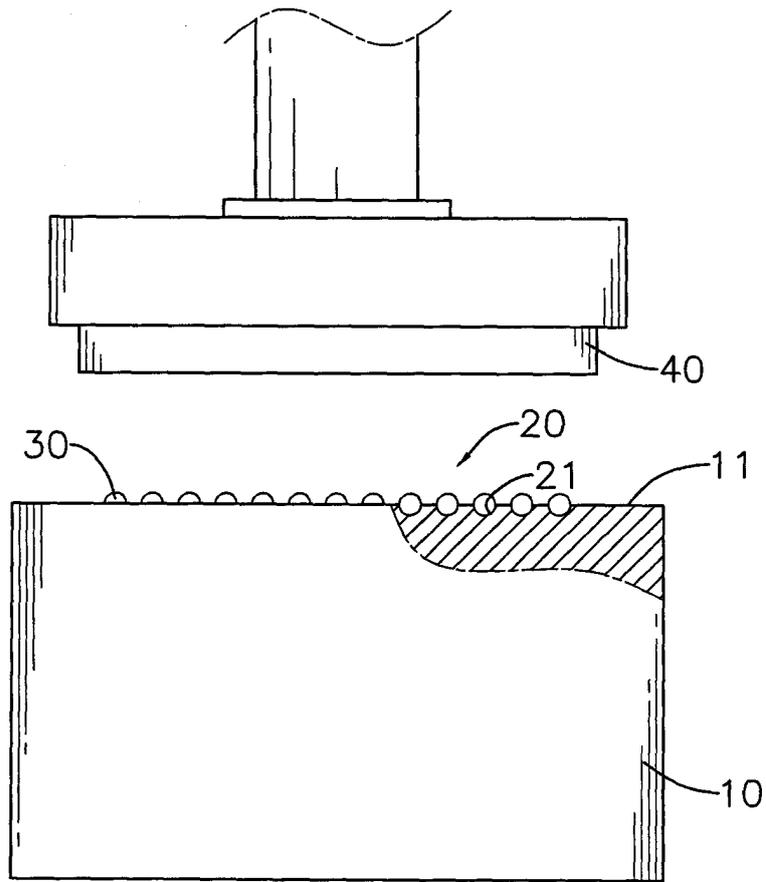
第一圖

(3)



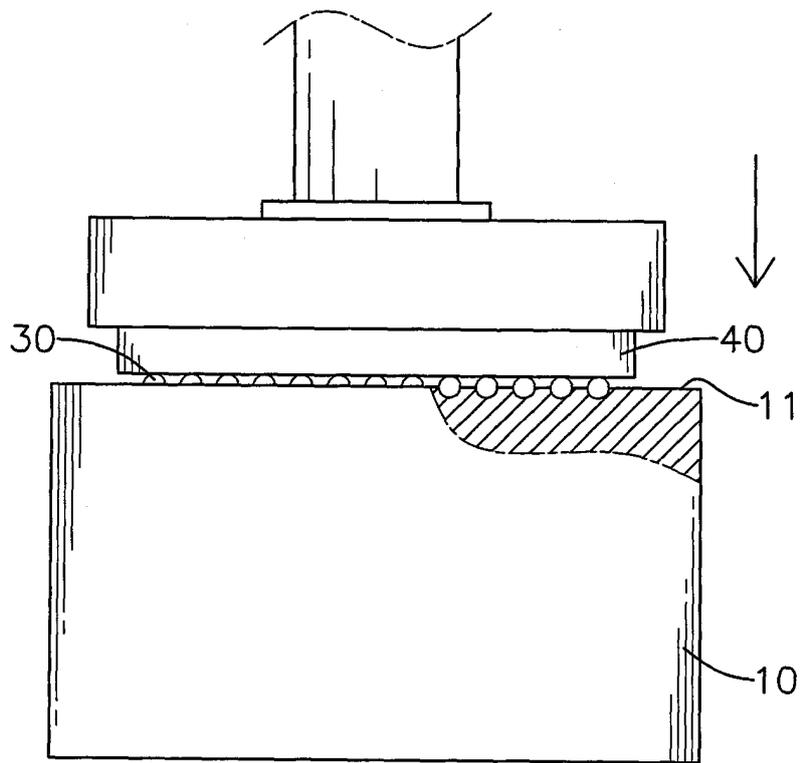
第二圖

(4)



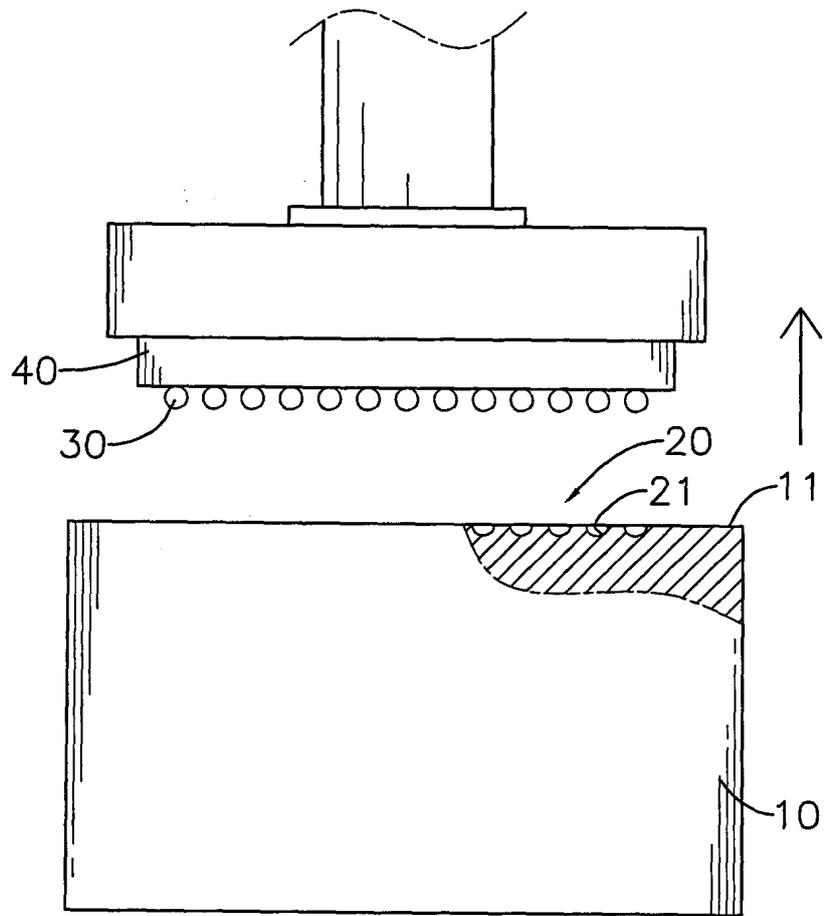
第三圖

(5)



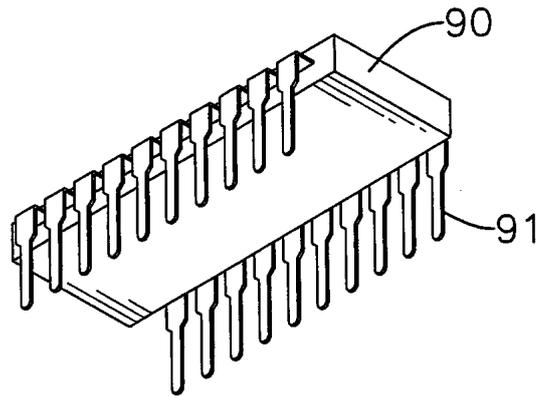
第四圖

(6)

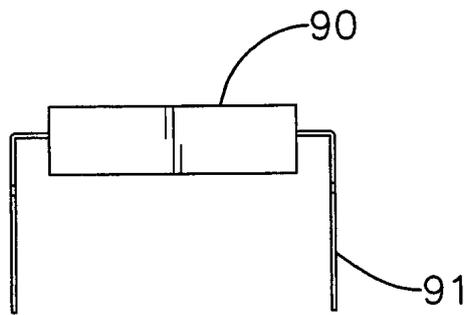


第五圖

(7)

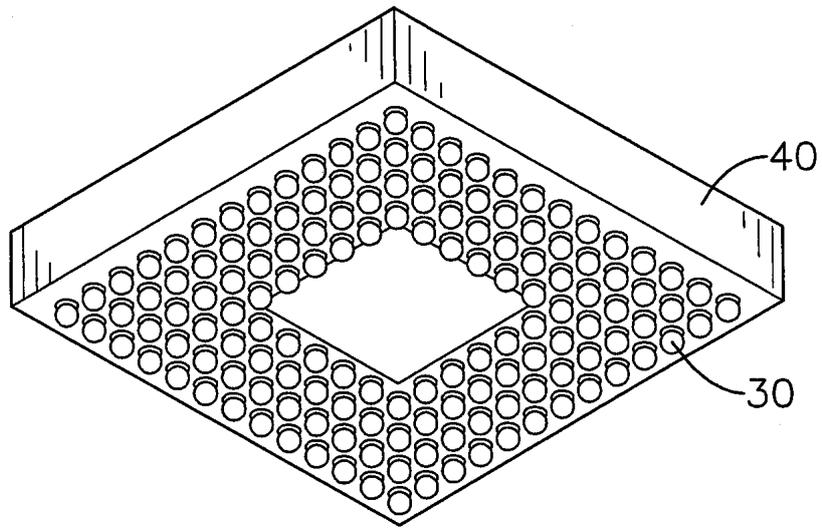


第六圖



第七圖

(8)



第八圖